

上海韦尔半导体股份有限公司

关于对全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：豪威半导体（上海）有限责任公司（以下简称“豪威半导体上海”）
- 增资金额：2,700 万美元
- 本次投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项，无须提交至公司股东大会审议批准。

一、增资情况概述

2019 年 10 月 22 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司增资的议案》，根据公司发展战略需要，公司对全资子公司豪威半导体上海增资 2,700 万美元。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交至股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

（一）出资方式

本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

豪威半导体上海为公司全资子公司。

公司全称	豪威半导体（上海）有限责任公司		
公司类型	有限责任公司		
法定代表人	HONGLI YANG		
成立日期	2001年1月19日		
注册地址	上海市松江区茸华路211号		
注册资本	5000万美元		
统一社会信用代码	91310000607426059H		
经营范围	研究开发、生产 CMOS 图像传感器、图像感应集成芯片及相关零部件和模具,硅基液晶产品及相关零部件,销售公司自产产品,并提供上述产品的商业性检测、仓储服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】		
财务数据			
项目	2018.12.31	项目	2018年
资产总额	52,927.92	营业收入	20,462.58
所有者权益	40,035.05	净利润	958.33

说明：以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次增资的目的及对公司的影响

（一）豪威半导体上海为公司全资子公司，按照公司《对外投资管理制度》和《子公司管理制度》等有关规定，豪威半导体上海建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资的风险可控。本次增资亦不存在因市场、技术、环保、财务等因素导致的风险。

（二）本次增资是为了促进公司“晶圆测试及晶圆重构生产线项目”的建设，以保障由豪威半导体上海负责实施的相关项目顺利开展实施。

（三）本次增资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2019年10月23日